

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二四年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2024年5月9日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二四年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二四年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 4.600 億美元，上年同期為 6.308 億美元，上季度為 4.554 億美元。
- 毛利率 6.4%，上年同期為 32.1%，上季度為 4.0%。
- 母公司擁有人應占溢利 3,180 萬美元，上年同期為 1.522 億美元，上季度為 3,540 萬美元。
- 基本每股盈利 0.019 美元，上年同期為 0.116 美元，上季度為 0.021 美元。
- 淨資產收益率（年化）2.0%，上年同期為 19.6%，上季度為 2.4%。

二零二四年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約在 4.7 億美元至 5.0 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 6%至 10%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二四年第一季度業績評論道：

“華虹半導體二零二四年第一季度銷售收入為 4.60 億美元，符合指引預期；單季毛利率為 6.4%，略高於指引。”

“整體半導體市場的景氣尚未擺脫低迷，且由於季節性和年度維修的影響，第一季度是代工企業的傳統淡季，但華虹半導體第一季度的產能利用率、銷售收入、毛利率均實現環比提升，驗證了公司特色工藝的市場需求總體向好。”

唐總繼續講道：“公司的第一條十二英寸生產線今年全年將在月產能 9.45 萬片的基礎上運行，第二條十二英寸生產線也正在建設過程中，預計將於年底建成投產。我們將緊跟市場趨勢，抓住市場機會，持續推進新技術的研發和現有工藝平臺的優化和提升，不斷強化公司在特色工藝領域的優勢，聚焦新質生產力，推動產業生態協同，實現華虹公司更快和更高品質的發展，以更優異的經營效益和投資回報回饋廣大投資者。”

電話會議公告

- 日期：2024年5月9日，星期四
- 時間：17:00 香港/上海時間
05:00 美國東部時間
- 發言人：唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播：會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/c543tkq6> 作線上直播
(請提前註冊登記)
- 電話直撥：請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN (個人身份識別碼)。
<https://register.vevent.com/register/BI96355b5c2077430bb0e4455877ac11c5>
重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。
- 網上重播：直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 9.45 萬片的 12 英寸晶圓廠 (“華虹無錫”), 這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線, 也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前, 本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線 (“華虹製造”) 的建設。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	459,986	630,842	455,361	(27.1)%	1.0 %
毛利	29,632	202,197	18,220	(85.3)%	62.6 %
毛利率	6.4 %	32.1 %	4.0 %	(25.7)	2.4
經營開支	(78,520)	(76,261)	(95,063)	3.0 %	(17.4)%
其他收入淨額	3,770	6,066	87,600	(37.9)%	(95.7)%
稅前(損失)/溢利	(45,118)	132,002	10,757	(134.2)%	(519.4)%
所得稅抵免/(開支)	19,832	8,900	(7,210)	122.8 %	(375.1)%
期內(損失)/溢利	(25,286)	140,902	3,547	(117.9)%	(812.9)%
淨利潤率	(5.5)%	22.3 %	0.8 %	(27.8)	(6.3)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	31,818	152,234	35,386	(79.1)%	(10.1)%
非控股權益	(57,104)	(11,332)	(31,839)	403.9 %	79.4 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.019	0.116	0.021	(83.6)%	(9.5)%
攤薄	0.019	0.115	0.021	(83.5)%	(9.5)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,026	1,001	951	2.5 %	7.9 %
產能利用率 ¹	91.7 %	103.5 %	84.1 %	(11.8)	7.6
淨資產收益率 ²	2.0 %	19.6 %	2.4 %	(17.6)	(0.4)

二零二四年第一季度

- 銷售收入 4.600 億美元，上年同期為 6.308 億美元，主要由於平均銷售價格下降，較上季度增長 1.0%。
- 毛利率 6.4%，上年同期為 32.1%，主要由於平均銷售價格下降及產能利用率降低，較上季度上升 2.4 個百分點，主要由於產能利用率提升。
- 經營開支 7,850 萬美元，同比上升 3.0%，主要由於研發工程片開支增加，環比下降 17.4%，主要由於上季度計提年終獎金所致。
- 其他收入淨額 380 萬美元，同比下降 37.9%，主要由於本季度為匯兌損失而上年同期為匯兌收益，部分被利息收入增加所抵消，環比下降 95.7%，主要由於政府補貼下降以及本季度為匯兌損失而上季度為匯兌收益。
- 所得稅抵免 1,980 萬美元，同比上升 122.8%，主要由於應課稅利潤下降。
- 期內損失 2,530 萬美元，上年同期為期內溢利 1.409 億美元，上季度為期內溢利 350 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 3,180 萬美元，上年同期為 1.522 億美元，上季度為 3,540 萬美元。
- 基本每股盈利 0.019 美元，上年同期為 0.116 美元，上季度為 0.021 美元。
- 淨資產收益率（年化）2.0%，上年同期為 19.6%，上季度為 2.4%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	437,060	95.0 %	605,718	96.0 %	(168,658)	(27.8)%
其他	22,926	5.0 %	25,124	4.0 %	(2,198)	(8.7)%
銷售收入總額	459,986	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,856)	(27.1)%

- 本季度 95.0%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	239,950	52.2 %	379,584	60.2 %	(139,634)	(36.8)%
12 吋晶圓	220,036	47.8 %	251,258	39.8 %	(31,222)	(12.4)%
銷售收入總額	459,986	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,856)	(27.1)%

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.400 億美元及 2.200 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	365,695	79.5 %	477,155	75.7 %	(111,460)	(23.4)%
北美 ⁴	46,241	10.1 %	70,760	11.2 %	(24,519)	(34.7)%
亞洲 ⁵	23,566	5.1 %	39,062	6.2 %	(15,496)	(39.7)%
歐洲	21,739	4.7 %	37,344	5.9 %	(15,605)	(41.8)%
日本 ⁶	2,745	0.6 %	6,521	1.0 %	(3,776)	(57.9)%
銷售收入總額	459,986	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,856)	(27.1)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 3.657 億美元，占銷售收入總額的 79.5%，同比下降 23.4%，主要由於智能卡芯片、IGBT、和超級結產品平均銷售價格及需求下降，部分被 MCU、邏輯、及 CIS 產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,620 萬美元，同比下降 34.7%，主要由於 MCU 產品需求及平均銷售價格下降，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,360 萬美元，同比下降 39.7%，主要由於 MCU、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 2,170 萬美元，同比下降 41.8%，主要由於智能卡芯片、IGBT 和通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 270 萬美元，同比下降 57.9%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	119,214	25.9 %	239,228	37.9 %	(120,014)	(50.2)%
獨立式非易失性存儲器	31,072	6.8 %	31,802	5.0 %	(730)	(2.3)%
分立器件	143,344	31.1 %	232,640	36.9 %	(89,296)	(38.4)%
邏輯及射頻	64,213	14.0 %	39,203	6.2 %	25,010	63.8 %
模擬與電源管理	101,495	22.1 %	87,535	13.9 %	13,960	15.9 %
其他	648	0.1 %	434	0.1 %	214	49.3 %
銷售收入總額	459,986	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,856)	(27.1)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.192 億美元，同比下降 50.2%，主要由於 MCU 及智能卡芯片的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 3,110 萬美元，同比下降 2.3%。
- 本季度分立器件銷售收入 1.433 億美元，同比下降 38.4%，主要由於 IGBT、超級結、及通用 MOSFET 產品的需求及平均銷售價格下降。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 6,420 萬美元，同比增長 63.8%，主要得益於 CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.015 億美元，同比增長 15.9%，主要由於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	94,477	20.6 %	58,514	9.2 %	35,963	61.5 %
90nm 及 95nm	88,516	19.2 %	119,348	18.9 %	(30,832)	(25.8)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	71,430	15.5 %	128,905	20.4 %	(57,475)	(44.6)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	29,912	6.5 %	43,928	7.0 %	(14,016)	(31.9)%
0.25 μ m	7,617	1.7 %	4,146	0.7 %	3,471	83.7 %
0.35 μ m 及以上	168,031	36.5 %	276,001	43.8 %	(107,970)	(39.1)%
銷售收入總額	459,983	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,859)	(27.1)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 9,450 萬美元，同比增長 61.5%，主要得益於 CIS 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 8,850 萬美元，同比下降 25.8%，主要由於智能卡芯片需求減少，部分被其他電源管理產品需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 7,140 萬美元，同比下降 44.6%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 2,990 萬美元，同比下降 31.9%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 760 萬美元，同比增長 83.7%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.680 億美元，同比下降 39.1%，主要由於 IGBT、超級結、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求及平均銷售價格下降。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	287,863	62.6 %	368,695	58.4 %	(80,832)	(21.9)%
工業及汽車	102,723	22.3 %	180,229	28.6 %	(77,506)	(43.0)%
通訊	61,204	13.3 %	62,809	10.0 %	(1,605)	(2.6)%
計算機	8,196	1.8 %	19,109	3.0 %	(10,913)	(57.1)%
銷售收入總額	459,986	100.0 %	630,842	100.0 %	(170,856)	(27.1)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 2.879 億美元，占銷售收入總額的 62.6%，同比下降 21.9%，主要由於超級結及智能卡芯片的平均銷售價格及需求下降，部分被其他電源管理、閃存、邏輯及 CIS 產品的需求增加所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.027 億美元，同比下降 43.0%，主要由於 MCU、IGBT、及通用 MOSFET 產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,120 萬美元，同比下降 2.6%，主要由於智能卡芯片需求下降，部分被 CIS、模擬、邏輯及射頻產品需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 820 萬美元，同比下降 57.1%，主要由於通用 MOSFET 及 MCU 產品需求減少。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合仟片晶圓)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	95	65	95
合計產能(折合 8 吋仟片晶圓)	391	324	391
產能利用率 (200mm)	100.3%	107.1%	91.0%
產能利用率 (300mm)	84.2%	99.0%	77.5%
總體產能利用率	91.7%	103.5%	84.1%

- 本季度末月產能 391,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 91.7%，較上季度上升 7.6 個百分點。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋片晶圓	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,026	1,001	951	2.5 %	7.9 %

- 本季度付運晶圓 1,026,000 片，同比上升 2.5%，環比上升 7.9%。

經營開支分析

以仟美元計	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,985	2,688	2,684	(26.2)%	(26.0)%
管理費用 ⁸	76,535	73,573	92,379	4.0 %	(17.2)%
經營開支	78,520	76,261	95,063	3.0 %	(17.4)%

- 經營開支 7,850 萬美元，同比上升 3.0%，主要由於研發工程片開支增加，環比下降 17.4%，主要由於上季度計提年終獎金所致。

其他收入淨額

以仟美元計	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,560	3,464	3,447	2.8 %	3.3 %
利息收入	25,020	11,364	20,182	120.2 %	24.0 %
匯兌(損失)/收益	(5,850)	16,536	27,041	(135.4)%	(121.6)%
分佔聯營公司溢利	1,411	1,520	7,136	(7.2)%	(80.2)%
財務費用	(24,585)	(28,413)	(19,540)	(13.5)%	25.8 %
政府補貼	3,799	788	51,387	382.1 %	(92.6)%
其他	415	807	(2,053)	(48.6)%	(120.2)%
其他收入淨額	3,770	6,066	87,600	(37.9)%	(95.7)%

- 其他收入淨額 380 萬美元，同比下降 37.9%，主要由於本季度為匯兌損失而上年同期為匯兌收益，部分被利息收入增加所抵消，環比下降 95.7%，主要由於政府補貼下降以及本季度為匯兌損失而上季度為匯兌收益。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	40,660	131,868	196,546	(69.2)%	(79.3)%
投資活動所用現金流量淨額	(298,951)	(203,281)	(301,916)	47.1 %	(1.0)%
融資活動所得現金流量淨額	789,913	263,249	642,297	200.1 %	23.0 %
外匯匯率變動影響淨額	(8,817)	17,946	58,753	(149.1)%	(115.0)%
現金及現金等價物變動影響淨額	522,805	209,782	595,680	149.2 %	(12.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 4,070 萬美元，同比下降 69.2%，環比下降 79.3%，主要由於客戶收款及政府補助減少所致。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.990 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 3.026 億美元，及其他權益工具投資 1,760 萬美元，部分被收到利息收入 2,120 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 7.899 億美元，其中非控股權益資本注資 6.894 億美元，提取銀行借款 1.034 億美元，及員工行權發行股份收到 10 萬美元，部分被支付利息 210 萬美元，及支付租賃負債 90 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (已審核)
資產總額	11,648,010	10,943,420
負債總額	2,980,801	2,928,876
所有者權益總額	8,667,209	8,014,544
資產負債率 ⁹	25.6%	26.8%

資本開支

以仟美元計	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	31,728	28,761
華虹無錫	71,417	121,918
華虹製造	199,429	180,690
合計	302,574	331,369

- 本季度資本開支 3.026 億美元，其中 1.994 億美元用於華虹製造，7,140 萬美元用於華虹無錫，及 3,170 萬美元用於華虹 8 吋。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (已審核)
發展中物業	194,181	178,828
存貨	431,206	449,749
貿易應收款項及應收票據	306,151	278,669
預付款項、其他應收款項及其他資產	53,242	33,821
應收關聯方款項	15,688	11,219
已凍結存款及定期存款	32,032	32,088
現金及現金等價物	6,107,986	5,585,181
流動資產總額	7,140,486	6,569,555
貿易應付款項	239,261	235,410
其他應付款項及暫估費用	379,133	430,478
計息銀行借款	232,201	193,035
租賃負債	6,257	3,076
政府補助	41,643	35,017
應付關聯方款項	9,704	13,876
應付所得稅	59,018	61,495
流動負債總額	967,217	972,387
淨營運資金	6,173,269	5,597,168
速動比率	6.7x	6.1x
流動比率	7.4x	6.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	58	60
存貨周轉天數	92	97

- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 3,380 萬美元上升至本季度末的 5,320 萬美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 1,120 萬美元上升至本季度末的 1,570 萬美元，主要由於應收一家關聯方的款項增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 4.305 億美元下降至本季度末的 3.791 億美元，主要由於本季度支付資本開支款及年終獎金所致。
- 計息銀行借款由上季度末的 1.930 億美元上升至本季度末的 2.322 億美元，主要由於一年內到期的長期借款增加。
- 政府補助由上季度末的 3,500 萬美元上升至本季度末的 4,160 萬美元，主要由於政府項目收款增加。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,390 萬美元下降至 970 萬美元，主要由於本季度支付一家關聯方技術採購款項。
- 淨營運資金 本季度末 61.733 億美元，流動比率 7.4。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 58 天。
- 存貨周轉天數 92 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)
銷售收入	459,986	630,842	455,361
銷售成本	(430,354)	(428,645)	(437,141)
毛利	29,632	202,197	18,220
其他收入及收益	32,851	32,970	100,442
投資物業的公平值收益	-	-	103
銷售及分銷費用	(1,985)	(2,688)	(2,684)
管理費用	(76,535)	(73,573)	(92,379)
其他費用	(5,907)	(11)	(541)
財務費用	(24,585)	(28,413)	(19,540)
分佔聯營公司溢利	1,411	1,520	7,136
稅前(損失)/溢利	(45,118)	132,002	10,757
所得稅抵免/(開支)	19,832	8,900	(7,210)
期內(損失)/溢利	(25,286)	140,902	3,547
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	31,818	152,234	35,386
非控股權益	(57,104)	(11,332)	(31,839)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.019	0.116	0.021
攤薄	0.019	0.115	0.021
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,716,634,650	1,307,286,436	1,716,439,808
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,718,334,991	1,318,907,456	1,720,215,394

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (已審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,587,363	3,519,292	3,436,656
投資物業	166,354	166,643	171,653
使用權資產	79,347	78,545	84,063
無形資產	46,526	49,827	31,217
於聯營公司的投資	140,270	139,099	134,017
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	287,089	270,506	181,597
長期預付款項	200,074	149,953	6,903
遞延稅項資產	501	-	14,673
非流動資產總額	4,507,524	4,373,865	4,060,779
流動資產			
發展中物業	194,181	178,828	143,960
存貨	431,206	449,749	593,922
貿易應收款項及應收票據	306,151	278,669	306,062
預付款項、其他應收款項及其他資產	53,242	33,821	38,657
應收關聯方款項	15,688	11,219	15,348
已凍結存款及定期存款	32,032	32,088	1,056
現金及現金等價物	6,107,986	5,585,181	2,218,547
流動資產總額	7,140,486	6,569,555	3,317,552
流動負債			
貿易應付款項	239,261	235,410	220,243
其他應付款項及暫估費用	379,133	430,478	441,795
計息銀行借款	232,201	193,035	408,669
租賃負債	6,257	3,076	5,582
政府補助	41,643	35,017	38,165
應付關聯方款項	9,704	13,876	7,944
應付所得稅	59,018	61,495	98,314
流動負債總額	967,217	972,387	1,220,712
流動資產淨額	6,173,269	5,597,168	2,096,840
總資產減流動負債	10,680,793	9,971,033	6,157,619
非流動負債			
計息銀行借款	1,993,525	1,906,526	1,496,396
租賃負債	17,714	19,129	19,080
遞延稅項負債	2,345	30,834	11,463
非流動負債總額	2,013,584	1,956,489	1,526,939
淨資產	8,667,209	8,014,544	4,630,680
權益和負債權益			
股本	4,934,028	4,933,559	1,996,528
儲備	1,389,777	1,367,436	1,229,318
本公司擁有人應佔權益	6,323,805	6,300,995	3,225,846
非控股權益	2,343,404	1,713,549	1,404,834
權益總額	8,667,209	8,014,544	4,630,680

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前(虧損)/溢利	(45,118)	132,002	10,757
折舊及攤銷	133,088	120,338	129,135
應佔聯營公司溢利	(1,411)	(1,520)	(7,136)
營運資金的變動及其它	(45,899)	(118,952)	63,790
經營活動所得現金流量淨額	40,660	131,868	196,546
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(302,574)	(216,620)	(331,369)
投資其他權益工具	(17,618)	-	-
收到政府對物業、廠房及設備的補助	-	-	11,692
其他投資活動所得現金流量	21,241	13,339	17,761
投資活動所用現金流量淨額	(298,951)	(203,281)	(301,916)
融資活動所得現金流量：			
非控股權益資本注資	689,430	296,197	491,723
提取銀行貸款	103,405	12,972	246,620
償還銀行貸款	-	(42,527)	(54,942)
已付利息	(2,155)	(3,830)	(45,234)
支付租賃負債	(881)	(756)	(274)
發行股份所得收益	114	1,442	1,407
其他融資活動所(用)/得現金流量	-	(249)	2,997
融資活動所得現金流量淨額	789,913	263,249	642,297
現金及現金等價物增加淨額	531,622	191,836	536,927
外匯匯率變動影響淨額	(8,817)	17,946	58,753
期初現金及現金等價物	5,585,181	2,008,765	4,989,501
期末現金及現金等價物	6,107,986	2,218,547	5,585,181

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
封松林

承董事会命

華虹半導體有限公司

張素心
董事長兼執行董事

中國 香港

二零二四年五月九日